PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-106902

(43)Date of publication of application: 24.04.1998

(51)Int.CI.

H01G 9/26

HO5K

(21)Application number: 08-262179

(71)Applicant: HONDA MOTOR CO LTD

(22)Date of filing:

02.10.1996

(72)Inventor: INABA ATSUSHI

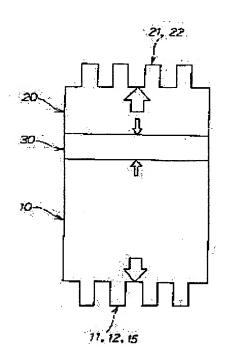
HIYAMA SATOSHI KAWABE KOJI

(54) CAPACITOR STRUCTURE FOR STORAGE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To measure the temperature of a capacitor without being influenced by the heat generated by a control circuit substrate by a method in which a heat insulating member is provided between an accumulating capacitor and the control circuit substrate in such a manner that the heat of the control circuit substrate is not transmitted to the accumulating capacitor.

SOLUTION: A heat insulating member 30 is provided between an accumulating capacitor 10 and a control circuit substrate 20, and when the accumulating capacitor is charged, the heat generated by the control circuit substrate 20 is not transferred to the accumulating capacitor 10 by the heat insulating action of the heat insulating member 30, and the heat is discharged from the cooling fins 21 and the longitudinal grooves 22 of the control circuit substrate 20. Also, the heat generated by the accumulating capacitor 10 is not transmitted to the control circuit substrate 20 by the



heat insulating action of the heat insulating member 30, and the heat is discharged from the cooling fin 11, the longitudinal groove 12 and the lateral groove 15. As a result, the temperature of the accumulating capacitor 10 can be measured by an electrothermo couple in a highly precise manner.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.11.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

Best Available Copy

[Date of registration] [Number of appeal against examiner's decision of rejection] [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-106902

(43)公開日 平成10年(1998) 4月24日

(51) Int.Cl.6

H01G 9/26

H05K 7/20

識別記号

FΙ

H01G 9/00

521

H05K 7/20

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平8-262179

(71) 出願人 000005326

本田技研工業株式会社

東京都港区南青山二丁目1番1号

(22)出願日

平成8年(1996)10月2日

(72) 発明者 稲葉 敦

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会

社本田技術研究所内

(72)発明者 樋山 智

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会

社本田技術研究所内

(72)発明者 川辺 浩司

埼玉県和光市中央1丁目4番1号 株式会

社本田技術研究所内

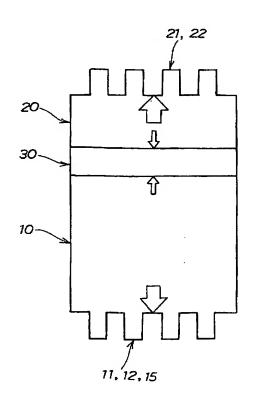
(74)代理人 弁理士 下田 容一郎

(54) 【発明の名称】 蓄電用コンデンサ構造

(57)【要約】

【解決手段】 蓄電用コンデンサ10と、この蓄電用コ ンデンサ10の電気量を制御するための制御回路基板2 0とを一体化した蓄電用コンデンサ構造において、蓄電 用コンデンサ10と制御回路基板20との間に断熱部材 30を設けて、制御回路基板20の熱を蓄電用コンデン サ10へ伝えぬようにした。

【効果】 蓄電用コンデンサと制御回路基板とを一体化 して小型・高密度化することができるとともに、制御回 路基板の発熱に影響されずに、コンデンサの温度を精度 よく測定することができる。



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 蓄電用コンデンサと、この蓄電用コンデンサの電気量を制御するための制御回路基板とを一体化した蓄電用コンデンサ構造において、前記蓄電用コンデンサと前記制御回路基板との間に断熱部材を設けて、制御回路基板の熱を蓄電用コンデンサへ伝えぬようにしたことを特徴とする蓄電用コンデンサ構造。

【請求項3】 蓄電用コンデンサと、この蓄電用コンデンサの電気量を制御するための制御回路基板とを互いに速やかに伝熱し合うように組付けたことを特徴とする蓄電用コンデンサ構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は蓄電用コンデンサ構造に関する。

[0002]

【従来の技術】コンデンサの測温技術に関するものとして、①特開平4-12520号公報「アルミ電解コンデンサ」、②特開平4-101408号公報「アルミ電解コンデンサ」が知られている。上記①,②の技術は、いずれもアルミ電解コンデンサの外部接続端子に感温素子を取付け、内部のコンデンサ素子の異常な温度上昇を検出して、コンデンサの電気回路を遮断するものである。【0003】上記①には、同公報の図に示される通り、一端に底部を有し他端を封口部材5でふさいだ金属ケース2と、この金属ケース2内に収納したコンデンサ素子1に接続したリード線3,3aと、これらのリード線3,3aに上記封口部材5の部接続端子4,4aと、この一方の外部接続端子4aに取付けた感温素子6とが開示されている。

【0004】上記②には、同公報の第1図に示される通り、一端に底部を有し他端を封口部材5でふさいだ金属ケース2と、この金属ケース2内に収納したコンデンサ素子1と、このコンデンサ素子1に接続したリード線3,3 aと、これらのリード線3,3 aに上記封口部材5の部分で接続した外部接続用端子4a,4と、この一方の外部接続用端子4に固定手段6で固定した感温素子7とが開示されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記①、②とも、コンデンサ素子1の温度が上昇しても、コンデンサ素子1で発生した熱はリード線3aを介して外部接続端子4a又 50

は外部接続用端子4に伝わるため、感温素子6又は感温素子7が温度上昇を感知するのに時間遅れが生じる。

【0006】また、金属ケース2内に収納されたコンデンサ素子1と、金属ケース2外で大気に触れた外部接続端子4a又は外部接続用端子4とでは、端子4a又は端子4の方が熱を逃がし易く、温度が下がりやすい。以上より、コンデンサ素子1と端子4a又は端子4との温度差が生じ、端子4a又は端子4に取付けた感温素子6又は感温素子7でコンデンサ素子1の温度を精度よく測定するのが難しい。

【0007】ところで、コンデンサは、このコンデンサの電気量を制御する制御回路基板を必要とし、この制御回路基板とコンデンサとを車両に積載する場合、車両内のスペースを有効に利用するために小型・高密度化が要求される。従って、制御回路基板とコンデンサとを密着させて使用することになる。

【0008】このように密着させて使用する場合、制御 回路基板から発生する熱がコンデンサに伝わり、コンデ ンサの温度を上昇させるため、コンデンサ内部の温度を 直接測定したとしても精度良く測定することはますます 困難になる。一方、コンデンサに測温体を取付けるのが 難しい場合、コンデンサ内部の温度を直接測定できなく なる。

【0009】そこで、本発明の目的は、小型・高密度であるとともに、制御回路基板から発生する熱に影響されることなしにコンデンサの温度を精度良く測定することができる蓄電用コンデンサ構造を提供することにある。また、本発明の目的は、小型・高密度であるとともに、コンデンサの外部からコンデンサの内部温度を推定することができる蓄電用コンデンサ構造を提供することにある

[0010]

30

40

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために本発明の請求項1は、蓄電用コンデンサと制御回路基板との間に断熱部材を設けて、制御回路基板の熱を蓄電用コンデンサへ伝えぬようにした。蓄電用コンデンサと制御回路基板とを一体化して小型・高密度化することができるとともに、制御回路基板の発熱に影響されずに、コンデンサの温度を精度よく測定することができる。

【0011】請求項2は、蓄電用コンデンサと前記制御回路基板との間に放熱部材を設け、制御回路基板の熱を放熱部材で放熱させることにより、蓄電用コンデンサへ伝えぬようにした。蓄電用コンデンサと制御回路基板とを一体化して小型・高密度化することができるとともに、制御回路基板の発熱に影響されずに、コンデンサの温度を精度よく測定することができる。

【0012】請求項3は、蓄電用コンデンサと、この蓄電用コンデンサの電気量を制御するための制御回路基板とを互いに速やかに伝熱し合うように組付けた。蓄電用コンデンサ及び制御回路基板は速やかに均一温度の発熱

体となり、外部に放熱するので、予め蓄電用コンデンサ の内部温度と外部温度との関係を求めることにより、外 部温度を測定すれば、蓄電用コンデンサの内部温度を常 に速やかに推定することができる。

[0013]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を添付図に基 づいて以下に説明する。なお、図面は符号の向きに見る ものとする。図1は本発明に係る蓄電用コンデンサ構造 の第1の実施の形態を示す斜視図であり、コンデンサ・ アレー1は、複数のコンデンサ10 (…は複数個を示 す。以下同様。)と、これらのコンデンサ10…のそれ ぞれに対応して電気量を制御する制御回路基板20… と、コンデンサ10…、制御回路基板20…間に設けた 断熱部材30とからなる。

【0014】コンデンサ10は、このコンデンサ10で 発生した熱を放熱するために、側面に形成した冷却フィ ン11…及び縦溝12…とをそれぞれに有する。それぞ れの制御回路基板20は、この制御回路基板20で発生 した熱を放熱するために、上面に形成した冷却フィン2 1…と、側面に形成した縦溝22…とを有し、また、上 20 面に後述する検出ターミナル23を有する。

【0015】断熱部材30は、①制御回路基板20…で 発生した熱がコンデンサ10…に伝わるのを防止する、 ②コンデンサ10…を連結する、③制御回路基板20… を取付ける役目をする。ここで、41,42は、コンデ ンサ・アレー1の正極・負極端子板、B5, B6は接続 用ボルトである。B7…はボルトであり、コンデンサ1 0…に断熱部材30を取付けるためのものである。B8 …はボルトであり、断熱部材30に制御回路基板20… を取付けるためのものである。

【0016】図2は図1の2矢視図であり、コンデンサ 10のフランジ部13に開けためねじ14を形成し、一 方、断熱部材30にボルト孔31を開け、ボルトB7を ワッシャWを介して断熱部材30のボルト孔31に挿入 し、コンデンサ10のめねじ14にねじ込んで、コンデ ンサ10に断熱部材30を取付ける状態を示す。

【0017】また、図2は、断熱部材30にめねじ32 を形成し、一方、制御回路基板20にポルト孔24を開 け、ボルトB8をワッシャWを介して制御回路基板20 のボルト孔24に挿入し、断熱部材30のめねじ32に ねじ込んで、断熱部材30に制御回路基板20を取付け る状態を示す。なお、15…は横溝であり、コンデンサ 10の底面に形成して、底面から放熱するものである。 ここで、めねじ14、ボルト孔31、めねじ32及びボ ルト孔24は、1組のコンデンサ10及び制御回路基板 30を取付けるためにそれぞれ2ヵ所ずつ形成するもの である。

【0018】図3(a)~(c)は本発明に係る蓄電用 コンデンサ構造の第1の実施の形態の接続部を説明する

熱部材の上面図(図の左側)、側面図(図の中央)及び 底面図(図の右側)、(c)はコンデンサの上面図であ る。 (a) において、制御回路基板20は、底面に接続 端子A1, B1, E1, H1, J1を有する。

【0019】 (b) において、断熱部材30は、上面に 突出させた接続端子A4, B4, E4, H4, J4と、 下面に突出させた接続端子B3, E3, H3, J3とを 有する。接続端子A4,B4,E4,H4,J4は、断 熱部材30に制御回路基板20を取付けた時に、それぞ れ制御回路基板20の接続端子A1, B1, E1, H 1, J1に接続する。

【0020】(c)において、コンデンサ10は、上面 に接続端子B, E, H, Jを有する。これらの接続端子 B, E, H, Jは、コンデンサ10に断熱部材30を取 付けた時に、接続端子B3,E3,H3,J3に接続す

【0021】図4は本発明に係る蓄電用コンデンサ構造 の第1の実施の形態の電気回路を説明する図である。コ ンデンサ10と制御回路基板20と断熱部材30の一部 とでコンデンサ・モジュールを構成し、図2は1つのコ ンデンサ・モジュールについての電気回路を示したもの である。他のコンデンサ・モジュールについても、同様 の回路構成を有する。コンデンサ10は、蓄電するため の電気二重層コンデンサ16と、この電気二重層コンデ ンサ16の温度を検出するための熱電対17とを備え

【0022】電気二重層コンデンサ16は、大容量(例 えば、数ファラッド) のコンデンサで構成し、図示せぬ 外部充電器で充電して所定の電気量(電荷量)を蓄積 し、複数個の充電されたコンデンサを接続して電気自動 車等のモータを駆動するために必要な電力に対応した電 気量を蓄えるものである。熱電対17は、電気二重層コ ンデンサ16に充電する際に発生する熱による温度上昇 を監視するものである。

【0023】コンデンサ10において、接続端子B, E は、電気二重層コンデンサ16の各極板に接続する。接 続端子H, Jは、熱電対17に接続する。断熱部材30 において、接続端子B3, E3, H3, J3は、接続端 子B4, E4, H4, J4にそれぞれ導通する。接続端 子B3は、負極端子板42に接続する。接続端子A4 は、コンデンサ・モジュールの正極であり、隣接するコ ンデンサ・モジュール(不図示)の負極(このコンデン サ・モジュールの接続端子B3に相当)に導通する。

【0024】制御回路基板20は、スイッチ素子25 と、バイバス導体26とを備える。制御回路基板20に おいて、接続端子A1, B1, E1は、スイッチ素子2 5の端子P, D, Cに導通する。

【0025】また、接続端子B1,E1は、接続端子L 2, K2に導通する。これらの接続端子L2, K2から 図であり、(a)は制御回路基板の底面図、(b)は断 50 電気二重層コンデンサ16の極板間の電圧を出力する。

30

接続端子H1,J1は、接続端子H2,J2に導通す る。これらの接続端子H2, J2から熱電対17の起電 力を出力する。上記の接続端子L2, G2, K2, H 2. J2は、検出ターミナル23 (図1参照) に取付け た端子である。

【0026】このような構成により、各コンデンサ10 の電圧、温度を検出ターミナル23から検出することが でき、各コンデンサ10の蓄電状態を把握し、適正な温 度管理を行うことができる。

【0027】接続端子G2は、スイッチ素子25へ制御 信号を入力するための端子である。スイッチ素子25 は、制御用の端子を有する1回路2接点形式の電子スイ ッチで構成し、図示せぬ制御手段からの制御信号に基づ いてノーマル状態(実線表示)では電気二重層コンデン サ16側の端子Cを接続端子A1に接続して、コンデン サ10を利用し、ブレーク状態(破線表示)ではバイパ ス導体26側の端子Dを接続端子A1に接続してコンデ ンサ10をバイパスさせる。

【0028】以上に述べた断熱部材30の作用を次に説 明する。図5は本発明に係る蓄電用コンデンサ構造の第 20 1の実施の形態の断熱部材の作用を説明する模式図であ り、コンデンサ10に充電を行う場合、コンデンサ10 及び制御回路基板20からそれぞれ熱が発生する。制御 回路基板20で発生した熱は、断熱部材30の断熱作用 によってコンデンサ10に伝わらず、制御回路基板20 の冷却フィン21及び縦溝22から放熱する。。

【0029】また、コンデンサ10で発生した熱は、断 熱部材30の断熱作用によって制御回路基板20に伝わ らず、コンデンサ10の冷却フィン11、縦溝12及び 横溝15から放熱する。なお、図中の小さな矢印は、断 熱部材30で伝熱が阻止されて、この方向に熱が流れに くいことを示し、大きな矢印は、コンデンサ10及び制 御回路基板20から放熱して、熱がこの方向に流れやす いことを示す。

【0030】このように、制御回路基板20からコンデ ンサ10に熱が伝わらないので、コンデンサ10を充電 する場合に、コンデンサ10内の温度を制御回路基板2 0からの熱に影響されることなく、熱電対17 (図4参 照) で精度よく測定することができる。

【0031】特に、急速充電すると、コンデンサ10の 40 温度が高くなるため、コンデンサ10を破損させず、且 つ充電効率のよい上限温度を維持するには、コンデンサ 10の測温精度が重要であり、本発明のこの実施の形態 によって、コンデンサ10の急速充電が実施可能とな

【0032】更に、この断熱部材30によって、コンデ ンサ10と制御回路基板20とを断熱部材の厚さしか離 さずに配置することができ、コンデンサ10と制御回路 基板20とで構成するコンデンサ・モジュールをコンパ クトにすることができて、スペースを有効に利用するこ 50 の負極板75に接続するコモン端子、77は負極板75

とができる。

【0033】図6は本発明に係る蓄電用コンデンサ構造 の第2の実施の形態を示す平面図であり、図1に示した 第1の実施の形態の断熱部材に替えてコンデンサと制御 回路基板との間に介在させる放熱部材を示す。なお、第 1の実施の形態と同一の構成要素については同一符号を 付け、詳細説明は省略する。放熱部材50は、冷却水を 流すための通路51と、この通路51の給水口52及び 排水口53とを備える。

【0034】通路51は、給水側経路51aと、排水側 10 経路51bと、これらの給水側経路51a及び排水側経 路51bを繋ぐ連結路51c…,51d…とからなる。 ここで、54、55はホース、56、57はホースクラ ンプである。

【0035】図7は図6の7-7線断面図であり、放熱 部材50の給水側経路51a、排水側経路51及び連結 路51c, 51d (連結路51dは図6参照) のそれぞ れの断面は、図に示した円形の他に楕円、矩形であって もよく、通路51内には、冷却水Fが満たされる。

【0036】以上に述べた放熱部材50の作用を次に説 明する。図8は本発明に係る蓄電用コンデンサ構造の第 2の実施の形態の放熱部材の作用を説明する模式図であ り、制御回路基板20で発生した熱は、放熱部材50に 流した冷却水下に伝わり、この冷却水下は外部に送られ

【0037】また、コンデンサ10で発生した熱も、冷 却水Fに伝わり、この冷却水Fは外部に送られる。な お、図中の矢印①は、コンデンサ10及び制御回路基板 20から放熱部材50への熱の移動を示し、矢印②は、 冷却水Fに伝わった熱が冷却水Fとともに移動すること を示し、矢印③は、放熱部材50の他のコンデンサ10 及び制御回路基板20からの放熱を示す。

【0038】このように、制御回路基板20からの熱 は、放熱部材50に放熱され、コンデンサ10に熱が伝 わらないので、コンデンサ10を充電する場合に、コン デンサ10内の温度を制御回路基板20からの熱に影響 されることなく、熱電対17で精度よく測定することが できる。

【0039】図9は本発明に係る蓄電用コンデンサの第 3の実施の形態を説明する図であり、容器61内にコン デンサ70と制御回路基板62とを収納し、この容器6 1内に伝熱媒体としての液体Mを満たした状態を示す。 なお、この容器61の内側と外側とでは、熱の出入りは ないものとする。制御回路基板62は、図示せぬシール 部材で覆われ、液シール性を有する。

【0040】ここで、61aは液体Mの温度を測定する ための測温体、71は正極板、72は複数の正極板71 に接続するコモン端子、73は正極板71に接続する正 極端子、74は端子保持部、75は負極板、76は複数

に接続する負極端子、78は端子保持部、82は制御回 路基板62の出力端子、Rは電解液である。

【0041】以上に述べた蓄電用コンデンサ構造の作用 を次に説明する。図10(a), (b)は本発明に係る 蓄電用コンデンサ構造の第3の実施の形態の作用を示す グラフである。 (a) はコンデンサ内部温度と液体の温 度との関係を求めるためのグラフであり、縦軸は温度 T、横軸は時間 t を表わす。(b) は液体温度からコン デンサ内部温度を推定するグラフであり、縦軸はコンデ ンサ温度T1、横軸は液体温度T3を表わす。

【0042】以下に充電時におけるコンデンサ70の内 部温度を求める方法を図9及び図10を用いて説明す る。図10(a)において、予めコンデンサ70の内部 温度T1と液体Mとの関係を求めるための方法を示す。 外部温度が一定である場合に、充電前のコンデンサ70 の内部温度T1、即ち今、コンデンサ70の電解液Rの 温度T1と、コンデンサ70の外部温度である液体Mの 温度T2とが同じ温度T11であるとする。

【0043】この状態で、時間 t = t 1となったとき に、コンデンサ70に充電を開始する。これにより、コ ンデンサ70及び制御回路基板62から熱が発生し、コ ンデンサ70と制御回路基板62とは、液体Mを介して 互いに速やかに伝熱し合い、コンデンサ70の内部温度 T1は、T1=T12に上昇する。この場合に、液体M の温度T3は、コンデンサ70及び制御回路基板62か らの伝熱によってT32に上昇する。以上より、コンデ ンサ内部温度T1と液体Mの温度との関係が一義的に求 まる。

(b) において、既知の液体Mの温度T3から未知のコ 30 ンデンサ70の内部温度T1を推定することができる。 例えば、液体Mの温度T3がT3=TXのときに、上記 コンデンサ内部温度T1と液体Mの温度との関係より、 コンデンサ70の内部温度T1はT1=TYと推定する ことができる。従って、制御回路基板62等に、前記 (b) の温度テーブルを記憶した記憶回路を備えること

【0044】このように、(a)で求めた関係から

により、常に液体Mの温度(外部の温度)T3からコン デンサ70の内部温度T1を知ることができる。

【0045】図11は本発明に係る蓄電用コンデンサの 第3の実施の形態の変形例を示す断面図であり、図9で 示した容器61に供給口63及び排出口64を取付け、 これら供給口63及び排出口64に液体Mの循環路65 を取付け、この循環路65に液体Mの温度を下げるため のクーラー66と液体Mを循環させるためのポンプ67 と液体Mの循環流量を測定するための流量計68とを介 在させ、上記供給口63及び排出口64に液体Mの温度 を測定するための測温体69a,69bを取付けた状態 を示す。

【0046】流量計68からの流量信号SFは、温度制 御手段81に送られる。測温体69a,69bからの温 50 デンサと、この蓄電用コンデンサの電気量を制御するた

8

度信号Ti, Toも、温度制御手段81に送られる。温 度制御手段81は、流量信号SF及び温度信号Ti,T oに基づいて、上記クーラー66に制御信号SCを送 り、液体Mの温度を制御する。また、温度制御手段81 は、ポンプ67に制御信号SPを送り、液体Mの循環量 を制御する。

【0047】以上に述べた蓄電用コンデンサ構造の第3 の実施の形態の変形例の作用を次に説明する。充電時に おけるコンデンサ70の電解液Rの温度を求める方法を 10 以下に示す。

1) まず、クーラー66及びポンプ67を作動させ、液 体Mを循環させて、液体Mを所定の温度、流量に設定す る。

2) コンデンサ70に充電を開始する。これにより、コ ンデンサ70及び制御回路基板62から熱が発生し、こ の熱が液体Mに伝わり、液体Mの温度を上昇させる。な お、充電開始と同時にクーラー66での温度制御を解除 する。

【0048】ここで、コンデンサから発生する単位時間 当りの熱量をQ1、制御回路基板62から発生する単位 時間当りの熱量をQ2とする。測温体69a,69bで 温度を測定することにより、単位時間当りに液体Mが受 ける熱量Q3が求まるから、この熱量Q3と熱量Q2と から熱量Q1が求まり、コンデンサ70の内部温度を算 出することができる。

【0049】以上のように、コンデンサ70と制御回路 基板62とを容器61に一括して収納したことで、コン デンサ70及び制御回路基板62で発生した熱を液体M に伝達させ、この液体Mの温度を測定することによっ て、コンデンサ70の温度を直接測定しなくとも、液体 Mとコンデンサ70の電解液R、制御回路基板62との 熱の授受を算出することができ、電解液Rの温度を推定 することができる。

【0050】また、このシステムでは、温度制御手段8 1、クーラー66及びポンプ67によって、上昇したコ ンデンサ70の温度を一旦所定の温度まで下げることが 可能となり、コンデンサ70の温度が充電に適する温度 を越えないようにすることができる。

【0051】尚、本発明の熱電対16は、これに限るも のではなく、白金線等の測温抵抗体でもよい。また、放 熱部材50の通路51の形状は、例えば、はしご形でも よい。更に、図9に示したコンデンサ70と制御回路基 板62との熱の授受を、液体Mを介さずに、例えば、コ ンデンサ70と制御回路基板62とを直接接触させた り、それらの間をヒートパイプで結合して互いに速やか に行なわせてもよい。

[0052]

【発明の効果】本発明は上記構成により次の効果を発揮 する。請求項1の蓄電用コンデンサ構造は、蓄電用コン

9

めの制御回路基板とを一体化した蓄電用コンデンサ構造において、蓄電用コンデンサと制御回路基板との間に断熱部材を設けて、制御回路基板の熱を蓄電用コンデンサへ伝えぬようにしたので、蓄電用コンデンサと制御回路基板とを一体化して小型・高密度化することができるとともに、制御回路基板の発熱に影響されずに、コンデンサの温度を精度よく測定することができる。

【0053】請求項2の蓄電用コンデンサ構造は、蓄電用コンデンサと、この蓄電用コンデンサの電気量を制御するための制御回路基板とを一体化した蓄電用コンデンサ機造において、蓄電用コンデンサと前記制御回路基板との間に放熱部材を設け、制御回路基板の熱を放熱部材で放熱させることにより、蓄電用コンデンサへ伝えぬようにしたので、蓄電用コンデンサと制御回路基板とを一体化して小型・高密度化することができるとともに、制御回路基板の発熱に影響されずに、コンデンサの温度を精度よく測定することができる。

【0054】請求項3の蓄電用コンデンサ構造は、蓄電用コンデンサと、この蓄電用コンデンサの電気量を制御するための制御回路基板とを互いに速やかに伝熱し合うように組付けたので、蓄電用コンデンサ及び制御回路基板は速やかに均一温度の発熱体となり、外部に放熱するので、予め蓄電用コンデンサの内部温度と外部温度との関係を求めることにより、外部温度を測定すれば、蓄電用コンデンサの内部温度を常に速やかに推定することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る蓄電用コンデンサ構造の第1の実施の形態を示す斜視図

10

【図2】図1の2矢視図

【図3】本発明に係る蓄電用コンデンサ構造の第1の実施の形態の接続部を説明する図

【図4】本発明に係る蓄電用コンデンサ構造の第1の実施の形態の電気回路を説明する図

【図5】本発明に係る蓄電用コンデンサ構造の第1の実 10 施の形態の断熱部材の作用を説明する模式図

【図6】本発明に係る蓄電用コンデンサ構造の第2の実施の形態を示す平面図

【図7】図6の7-7線断面図

【図8】本発明に係る蓄電用コンデンサ構造の第2の実施の形態の放熱部材の作用を説明する模式図

【図9】本発明に係る蓄電用コンデンサの第3の実施の 形態を説明する図

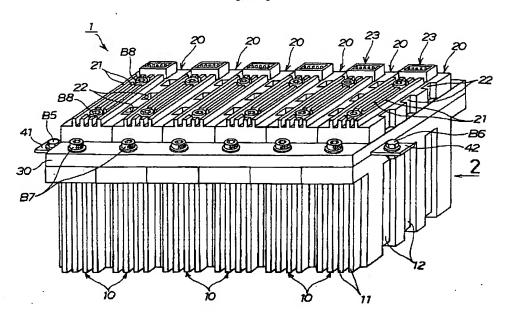
【図10】本発明に係る蓄電用コンデンサ構造の第3の 実施の形態の作用を示すグラフ

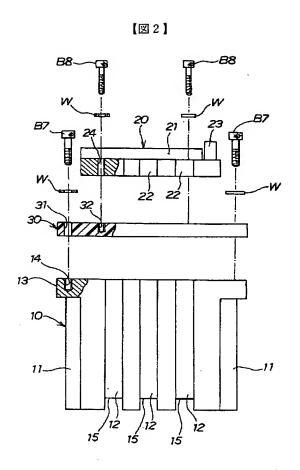
20 【図11】本発明に係る蓄電用コンデンサの第3の実施 の形態の変形例を示す断面図

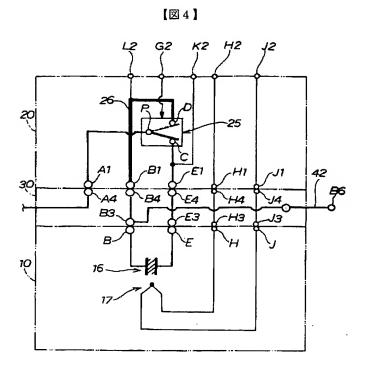
【符号の説明】

10,70…蓄電用コンデンサ、20,62…制御回路 基板、30…断熱部材、50…放熱部材、61…容器、 M…液体、F…冷却水、R…電解液。

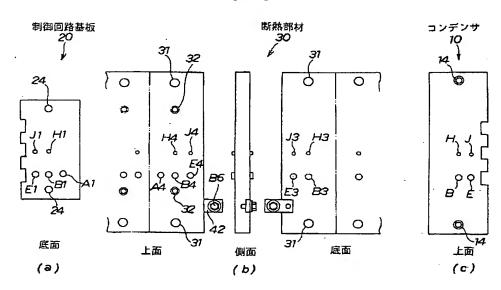
【図1】



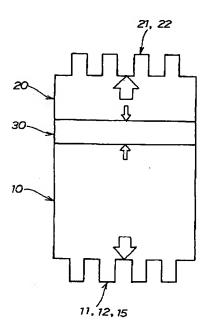




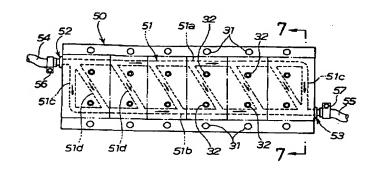




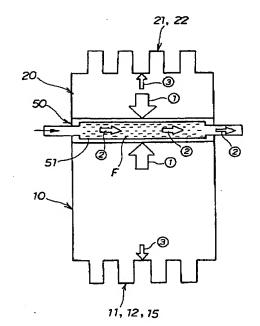
【図5】



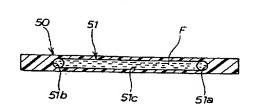
【図6】



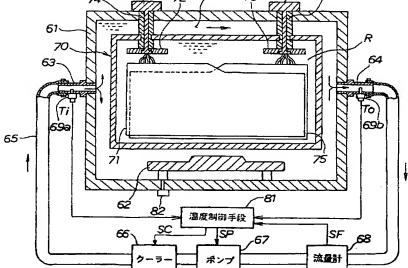
[図8]







【図10】 【図9】 ∠T1 (コンデンサ温度) T12 ₩ T32 .T3 (液体温度) T11 時間t (a) コンドン中弧倒 Li T12 ΤY T11 T32 T11 TX 液体温度 T3 (b)



【図11】

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.